

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2022-046

通富微电子股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋澍	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号	江苏省南通市崇川路 288 号	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
电子信箱	tfme_stock@tfme.com	tfme_stock@tfme.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	9,567,157,644.65	7,089,341,461.45	34.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	365,415,659.40	400,831,182.56	-8.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	311,006,497.21	362,620,554.80	-14.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,948,332,973.53	2,138,660,298.35	37.86%

基本每股收益（元/股）	0.28	0.30	-6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.30	-6.67%
加权平均净资产收益率	3.44%	4.10%	-0.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	30,616,307,400.48	27,101,066,163.89	12.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,901,017,584.46	10,441,986,798.89	4.40%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	168,684	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南通华达微电子集团股份有限公司	境内非国有法人	23.14%	307,541,893	0	质押	131,010,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	15.13%	201,082,279	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.97%	26,146,687	0		
南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.80%	23,929,329	0		
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	11,048,713	0		
中金期货有限公司－中金期货－融汇 1 号资产管理计划	其他	0.76%	10,104,828	0		
中国银行股份有限公司－国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	7,306,560	0		
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	6,891,444	0		
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	0.48%	6,430,868	0		
中国农业银行股份有限公司－富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）	其他	0.43%	5,760,221	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1 大股东与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）报告期内公司从事的主要业务

1、多元化发展，积极拓展国际国内业务，经营业绩稳步提升

公司主要从事集成电路封装测试一体化服务。2022 年上半年，尽管受到新冠疫情、俄乌冲突、消费品市场疲软等诸多不利因素影响，公司经营团队实施多元化发展路线，坚持国际化发展、大力拓展先进封装的经营思路，通过积极优化业务团队组织，进一步加强市场研究与拓展，不断提升本地化服务能力。报告期内，公司抓住市场机遇，维持高速增长，公司实现营业收入 95.67 亿元，同比增长 34.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.65 亿元，同比下降 8.84%；受汇率波动影响，公司产生“财务费用-汇兑损失”减少归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元，如剔除该非经营性因素的影响，公司归属于上市公司股东的净利润应该为 5.02 亿元，同比增加 25.42%。

公司开发国际市场 20 余年，自身市场竞争力不断提升，不断深化与客户在新兴领域的战略合作，上半年获得了与国际国内汽车电子知名企业英飞凌、恩智浦、意法半导体、博世、比亚迪、士兰微、合肥杰发等在处理器、电源管理、电池管理等领域的全方位合作机会。

公司坚持多元化发展路线，积极应对上半年半导体市场结构性短缺，快速调整产能布局，持续增加优势产品投资，助力半导体市场纾解结构性缺货问题，公司在数字隔离器、工控 MCU、电源逆变器、新能源模块、高性能运算等领域均进行投资并且实现快速增量。

公司在先进封测领域一直处于行业龙头地位，围绕高性能运算应用，依托在 FCBGA、Chiplet 方面优势地位，加强与 AMD 等行业领先企业的深度合作，进一步提升市场份额。

2、各工厂协同发展，打造国际一流封测基地

公司坚持创新引领、科技赋能，采用全球先进的设备和工艺，打造国际一流封测基地。公司布局七大生产基地，员工总数近 2 万人，生产总面积超过 100 万平米。

崇川工厂上半年实现营收 35.11 亿元，同比增长 7.83%；车载品全系列导入，上半年导入 84 个新项目；功率模块产品进入快速导入阶段，规模不断扩大，超小 DFN 项目获得产业化专项资金补助；为国际知名汽车电子客户开发的第三代半导体碳化硅产品，具备无铅化、耐高压、高功率等优势，应用于客户新能源车载逆变器等领域，在国内首家通过客户考核并进入量产；开发了适用于 DDR5 存储器件的凸点封装技术；导入国内头部通讯厂商的通讯组网芯片，为其提供 Bumping/CP/FCBGA 的一体化产品开发服务。

南通通富上半年实现营收 9.20 亿元，同比增长 83.15%。上半年导入考核新品 42 个、转量产 28 个，关键项目考核高效完成，获客户高层认可，将导入其所有 PA/基站类新品，并成为其第一供应商；打通 DSMBGA SiP 封装核心技术，具备量产能力；存储产品持续增量，上半年销售收入同比增加 67%；成功申报省工程技术研究中心项目。

合肥通富上半年实现销售收入 4.22 亿元。上半年进一步导入二家国际大客户；取得 SOP (SOL) 系列车载品量产资质，正式获得合肥海关 AEO 高级认证证书；连续第二年获得德州仪器全球卓越供应商奖；DRAM 建成 FC 产品线，连续三个季度获得国内知名存储客户季度评分第一名，其中今年二季度获得总分和质量双 A 级。显示驱动产品去年四季度、今年一季度连续两个季度被核心客户评为 A 级供应商。

通富超威苏州、通富超威槟城上半年合计实现营收 58.45 亿元，同比增长 60.16%，为实现全年经营目标打下坚实基础。通富超威苏州、通富超威槟城积极导入新产品，共完成 AMD 13 个新产品认证、其他客户 10 个新产品的导入工作；全力支持客户 5nm 产品导入，预计下半年开始小批量产，助力 CPU 客户高端进阶，为国内高端处理器产品爆发式增长做好配套封测服务。并购后，经过 6 年的不断发展，在 AMD 继续在 CPU 与 GPU 市场攻城略地的背景下，两个工厂的收入及利润达到并购前的 5 倍水平；专利申请及授权量远超并购前的水平，进一步夯实公司高端处理器封测技术世界领先地位。

3、技术研发硕果累累，持续提升核心竞争力

在 7nm、5nm 的后摩尔时代，先进制程的良率问题让流片费用居高不下，Chiplet 技术可以在提升良率的同时进一步降低设计成本和风险。公司通过在多芯片组件、集成扇出封装、2.5D/3D 等先进封装技术方面的提前布局，可为客户提供多样化的 Chiplet 封装解决方案，并且已为 AMD 大规模量产 Chiplet 产品。

FC 产品方面，已完成 5nm 制程的 FC 技术产品认证，同时在多芯片 MCM 技术方面已确保 9 颗芯片的 MCM 封装技术能力，并推进 13 颗芯片的 MCM 研发；在超大尺寸 FCBGA-MCM 高散热技术方面，具备了 Indium TIM 等行业前沿材料的稳定量产能力，并成功完成了新型散热片的开发，继续保持公司在 FCBGA 封装技术方面的行业领先地位。

Fanout 技术达到世界先进水平，高密度扇外型封装平台完成 6 层 RDL 开发，通过与传统基板配合，可解决高性能计算封装的高端基板短缺问题。

2.5D/3D 先进封装平台方面，取得突破性进展，BVR 技术实现通线并完成客户首批产品验证，2 层芯片堆叠的 CoW 技术完成技术验证。

先进存储器封装方面，完成用于高端服务器的三维堆叠存储器技术开发，实现多层堆叠的内存全流程存储功能测试；此外，完成用于高端手机的 LRDDR PoPt 封装开发，建立全套超薄存储器封装的翘曲控制解决方案。

公司在开展上述技术研发工作的同时，积极进行先进封测技术专利布局。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计国内外专利申请达 1,285 件，其中发明专利占比约 70%。

4、持续开展供应链战略管理，保障物资供应安全

2022 年上半年，受疫情影响，上海各地封控，物流运输受阻，经营层通过多方努力，将物资调配到公司，保障产线的正常运转，减少因材料、设备脱节对生产造成的损失。同时，建立供应链安全管理目标，对所有材料进行了梳理，加快推进国产材料验证和客户认证工作；针对计划外材料增加的需求，通过与供应商的急单沟通机制，实现快速响应，保单增量；持续开展降本工作，实现降本增效，为公司经营稳定增长，提供了有力支撑。

5、稳步扩张，保障发展空间

通富通科是公司第七个封测基地，位于南通市北高新区。2022 年上半年，通富通科一期约 2 万平米的改造厂房投入使用，二期约 3.4 万平米的厂房机电安装改造完成并顺利投产，创造了新的“通富速度”，为配合国家实现自主可控的存储器产品生产，做好厂房建设准备；南通通富三期约 7 万平米厂房及配套用房开始建设；2022 年 6 月 14 日，通富超威槟城启动新厂房建设仪式，新厂房占地约 85 亩，预计 2023 年竣工投入使用。

6、持续开展信息管理体系建设，提高科学化管理水平

加速进入“智改数转”新赛道，发挥智改数转新动力。以智能智造为前进方向，加快建设智能化物流进度，推动公司智能化改造，实现自动决策派单、AGV 机器人自动作业模式，夯实制造业数字化转型基础，获得“2022 年江苏省智能制造示范工厂”荣誉称号。

持续推进智能分析系统，建立集团数据仓库，应用大数据分析对海量生产数据建模、分析、预测，优化公司业务水平，辅助科学决策，为公司生产经营快速分析及决策提供信息，提高客户满意度，实现数字增值赋能，为公司数字化转型蓄力。

通富微电子股份有限公司

董事长：石明达

2022年8月23日